



BAMFIT Bonder / Tester 5600

Test System

Testkopf	Das speziell entwickelte Klemmwerkzeug greift den Bondfuß seitlich bei definierter Höhe; ein Touchdown-System gleicht variierende Substrathöhen automatisch aus.
Testwerkzeug	für Al-Dickdrähte von 125 bis 400 µm; durch den Bediener in Minuten austauschbar
Testzeit	1 Test < 1 Minute
Testkraft	Zugkraft in Z-Richtung, typ. 20 bis 50 cN
Testfrequenz	60 und 80 kHz, programmierbarer Ultraschall-Generator
Testamplitude	entspricht dem Temperaturhub beim PC Test; programmierbar von 0 bis 1 µm
Testdaten	Toolposition, Ultraschalldaten,... werden laufend registriert und zur späteren Auswertung in einer Datenbank gespeichert. Die statistische Auswertung und Analyse kann dann mit der CSR (Corporate Standard Report) Software durchgeführt werden.

BAMFIT-Tester

Das revolutionäre **BAMFIT-Testverfahren** ist durch einen speziellen Testkopf sehr einfach an jedem Basisgerät der Serie 56XX installierbar.

Die Software ist der Standard-Version für Bonder und Tester sehr ähnlich und erlaubt voll-automatisches Testen von beliebig vielen Bonds mit automatischer Feinjustierung der Testposition durch Bilderkennung.

Die Testresultate werden in einer Datenbank gespeichert und können jederzeit mit der CSR (Corporate Standard Report) Software analysiert und ausgewertet werden.

BAMFIT Zuverlässigkeits-Test

BAMFIT (Bond Accelerated Mechanical Fatigue Interconnection Test) ist ein völlig neuartiges Testverfahren, um Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Dickdraht-Wedgebonds abzuschätzen. Es ist die perfekte Erweiterung des klassischen Power-Cycling-Tests (PC): die zyklische Stressbelastung des Drahtbonds durch Temperaturwechsel wird durch mechanischen Stress nachgebildet, aber mit bedeutend höherer Zyklusgeschwindigkeit. Dadurch können PC-Tests, die häufig Wochen oder Monate dauern, innerhalb von Minuten simuliert werden.

Maschinenbasis

Arbeitsbereich	X/Y-Achse 100x100 mm / Z-Achse 60 mm
Achsen	Schrittauflösung 0,25 µm; Wiederholgenauigkeit <2 µm
Testkopf	Austauschbare Bond- und Testköpfe mit automatischer Erkennung
Hardware	Dual-Core PC mit Windows OS Ethernet, USB 2.0/3.0, LCD Farbdisplay 22" GigE-CMOS-Farbkamera Netzwerkfähig mit Programm-Archivierung
Software	Manuelle oder automatische Messungen an beliebig vielen Bonds
Abmessung	B x T x H – 70 x 65 x 70 cm, Gewicht ca. 80 kg
Anschlüsse	100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max. 500 VA Standard-Vakuumschlauch Ø 6 mm

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a
A-5280 Braunau am Inn
Tel.: +43-7722-67052-8270
Fax: +43-7722-67052-8272
Mail: info@fsbondtec.at
Web: www.fsbondtec.at

